



インプラント補綴 株式会社モリタWEBセミナー

## superimpose Module「DUPY」を用いたこれからのインプラント補綴 簡単コピー superimpose DUPY

現在、市販されているCAD/CAMシステムに、プリインストールされているモジュール(ソフトウェア)を使用し補綴を行っていくと、本当に必要とされる機能、特にインプラント補綴に於いてCADソフトの機能が部分欠如している事が判明する。よってデザインオペレーターの経験値が上がるほど欠如した部分を何等かの方法で補おうと努力をし、時間をかけ解決しようと試みる。

しかし、我が国ではそれを解決する為の研究開発や議論は殆ど行われず、デザインオペレーター、要するに技工士頼みの状況下でそのデザインに費やす時間や精度の検証も行われていないまま、既存のジュールを違う用途でアレンジしながら使用しているのが実情であった。

また、デジタルで解決できない補綴ステップを技工手法で何とか解決に漕ぎつけようと印象採得やパーツのアレンジなどをを行い何とか完成へと漕ぎつけていたのが現状であった。

本講演ではこれらの問題を解決すべく新しく開発を行なったモジュールを使用し、IOSデータを基点としたSuperimpose Techniqueを使用したデジタルインプラント補綴の新しい世界を供覧して頂きたい。

### 1部 シングルケース

THE POWER OF DIGITAL DREAM DENTISTRY  
— Superimpose Module DUPYを用いたシングルクラウンについて—

### 2部 フルケース

THE TRUTH OF DIGITAL IMPLANT PROSTHESIS  
— Superimpose Module DUPYを用いたフルマウス症例について—

\* 本セミナーは2部構成となっております。別々のお時間に聴講頂けます。

配信期間

2026年1月13日(火)~6月20日(土)

お問合せ

株式会社モリタ 大阪インプラントチーム

TEL 06. 6384 6921 FAX 06. 6384 6746

MAIL morita-seminar@morita.com

受付時間 9時~17時(土・日・祝祭日除く)

募集期間 2025年12月21日~

※期間中は繰り返し視聴いただけます。

受講料

無料

※当WEBセミナーの受講は、お申込みいただいたご本人様限定と致します。  
※当WEBセミナーの録画、録音、撮影など、一切の記録や複製によるアップロードなどの配信を禁止します。  
※wi-fi環境での受講をおすすめします。  
(カフェなどは一定の時間で通信が切られる場合がありますのでご注意ください)  
※通信状態により受講が困難となった場合の補償はできませんのでご了承ください。

講師



デンテックインターナショナル株式会社  
代表取締役

山下 恒彦先生

1988 米国にて DenTech International,Inc創業  
1991 日本にて デンテックインターナショナル(株)開業  
1995 UCLA歯学部顎顔面インプラント補綴科研究員  
1999 USC歯学部生涯研修科専任講師  
2000 A.I.T.所長  
2012 USC歯学部 Japan Program Course Director  
2016 USAISO/TC 106 USA Dentistry Active Voting Member  
2018 ADA(American Dental Association)Standers Committee

お申込み

お申込み受付期限内に、下の二次元バーコードからお申込みください。  
申込完了後「申込受付メール」が自動配信されます。  
ドメイン指定受信設定をされている場合は解除をお願い致します。

※お申込みには、モリタ友の会に登録(無料)が必要です。有料会員様はアドレスをご登録の上でご視聴いただけます。  
※ドメイン指定受信設定をされている場合は、morita-seminar@morita.comを受信できませんよう設定変更をお願い致します。

主催 モリタ友の会



入会するとお得!!

2026モリタ友の会  
入会予約受付中!

お申込みはWEBにてお願いいたします。

superimpose Module「DUPY」を用いたこれからのインプラント補綴

簡単コピー superimpose DUPY

2026年1月13日(火)~6月20日(土)

お申込みWEB

モリタ WEBセミナー

検索

ご記入いただいたお申し込み情報は、モリタ個人情報収集方針に準じ厳密に取り扱いたします。https://www.dental-plaza.com/policy/友の会セミナー開催に関する注意事項は www.dental-plaza.com/rule/semi.html に掲載しております。



携帯電話・スマートフォンからもお申込みいただけます。